

## 114 年度智慧財產權切結書

公佈時間：113 年 10 月 1 日

立書人\_\_\_\_\_ (請以教師為立書人), 茲就委託台灣半導體研究中心製作之晶片 / PCB 內容保證如下：

- 一、立書人保證其委託內容絕無任何違反專利權、著作權法、或其他智慧財產權之相關規定，若有涉及侵害他人專利權、著作權法、或其他智慧財產權之情事，立書人願負一切法律之責任並解決之。
- 二、本切結書內容，如有虛偽不實之情事，致使台灣半導體研究中心遭受損害，立書人願負完全責任。
- 三、本切結書適用於自簽署日起至至 114 年 12 月 31 日期間，立書人所申請之晶片製作申請案件。

此致

財團法人國家實驗研究院台灣半導體研究中心

立書人：

服務機關：\_\_\_\_\_ (請蓋系所科章)

姓 名：\_\_\_\_\_ (簽章)

地 址：\_\_\_\_\_

聯絡電話：\_\_\_\_\_

傳真號碼：\_\_\_\_\_

E - mail：\_\_\_\_\_

中華民國 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日